

# die-attach PX-413芯片粘接粘合剂 耐高温型芯片粘合剂

产品名称	die-attach PX-413芯片粘接粘合剂 耐高温型芯片粘合剂
公司名称	上海锐驰创通电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PX-413 品牌:Polymeric 粘合材料类型:电子元件、金属类
公司地址	中国 上海 上海市徐汇区 漕宝路103号自动化仪表城1号楼1301室
联系电话	86-021-64832039 13611807922

## 产品详情

型号	PX-413	品牌	Polymeric
粘合材料类型	电子元件、金属类		

die-attach adhesive芯片粘接剂

die-attachpx-413芯片粘接粘合剂 耐高温型芯片粘合剂

die-attach adhesive

耐高温芯片粘接粘合剂

die-attach adhesive

双马来酰亚胺树脂基芯片粘接粘合剂

polymeric px-413

产品简介：die-attach芯片粘接粘合剂 耐高温型芯片粘合剂。polymeric px-413是一种双马来酰亚胺树脂基芯片粘接粘合剂。它适用于在fr4或al2o3衬底上粘接硅芯片，并提供高导热性和耐高温性。polymeric px-413使丝网印刷达到最优化。

耐高温

高导热

## 丝网印刷和无需丝网印刷

### 说明

polymeric px-413是一种双马来酰亚胺树脂基芯片粘接粘合剂。它适用于在fr4或al2o3衬底上粘接硅芯片，并提供高导热性和耐高温性。polymeric px-413使丝网印刷达到最优化。

### 产品数据

#### 颜色 黄

粘度 (23 ) 中等 (丝网印刷和无需丝网印刷)

保质期 (2-35 ) 12个月

b阶固化 125 30分钟

烘烤 130 20分钟+175 60分钟

后焙烘 200 1小时 (可选)

### 工艺

#### 丝网印刷

该糊状粘合剂应用于结构化的丝网，然后将其转移印到基板上。粘合剂层厚应不超过400 μ m。当粘合剂转印到基板后，再进行b阶固化。

#### b阶固化

在125 30分钟固化 (粘接层厚度<400 μ m)

#### 装配条件

芯片尺寸：8mm × 8mm

基板温度：50

芯片温度：50

装配力：15 n

用层厚为250 μ m b 价粘合剂，将芯片陷入胶中70-100 μ m。释放装配力后，芯片将弹回18-24 μ m。

#### 固化

- 1。15分钟加热到130 ° c
- 2。20分钟恒温在130 ° c

3. 15分钟加热到175 ° c

4. 60分钟恒温在175 ° c

5. 60分钟降温至30 ° c

### 清洗设备

粘合剂的痕迹可以用丙酮去除。数量较大时使用n-甲基吡咯烷酮， - 丁内酯或亚甲基氯化物来溶解。当使用这些溶剂时，请遵守安全规定。避免接触皮肤和眼睛。

### 固化产品的典型特性

特性	方法	数值
分解温度	热重分析 ( tga ) 10k/min , 5%的重量损失	390
热膨胀	动态热机械分析/热机械分析(dma/tma) 2k/min 0.05n , 25-200	ca. 20ppm/k
玻璃化温度 tg		260
热点率		1.5w/mk
击穿电压e		3kv/mm
硬度	shore d	50

### 贮藏

在5-8 ，粘合剂保存在其原始的包装中。避免阳光的直射。存储期限为出厂日货后12月之内。

### 废弃物处置

为使用的粘合剂必须固化后再按照当地的法规进行处理。

### 安全措施

当使用粘合剂时，请佩戴安全眼镜和手套。更多信息请参阅msds.

产品链接：[http://www.acctrionics.com/productid/product\\_detail-10498072.html](http://www.acctrionics.com/productid/product_detail-10498072.html)

服务网址：[www.acctrionics.com](http://www.acctrionics.com)

服务电话：400-600-3652

锐驰创通电子科技有限公司努力为您提供优质服务